

东芯半导体股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于 2026 年 4 月 23 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年（以下简称“报告期”），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取得了良好的效果，现将行动方案 2026 年半年度评估情况公告如下：

一、聚焦公司主业，优化业务布局

2026 年上半年，受益于 AI 算力需求持续爆发，海外存储原厂加速退出利基型市场，供给端收缩态势明显；与此同时，网络通信、工业控制、汽车电子等下游应用需求稳步复苏，利基型存储芯片供需缺口持续扩大。公司所面对的存储芯片市场的供需关系呈现结构性紧缺态势，产品市场价格大幅攀升。公司紧抓市场机遇，以 SLC NAND Flash 为代表的存储业务实现量价齐升，带动上半年营业收入实现大幅增长，整体毛利率亦显著上涨，带动上半年利润水平的显著提高。2026 年上半年公司实现营业收入 14.97 亿元，同比增长 336.44%，第二季度营业收入环比增长 112.31%；2026 年上半年毛利率为 67.66%，比去年同期增加 48.90 个百分点。同时，公司以存储为核心，持续推进“存、算、联”一体化战略，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案。

（一）深耕主营业务，坚持技术创新

报告期内，公司针对各类主营存储产品，持续实施产品更新迭代策略，为网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子等应用领域提供多样化的存储产品解决方案。

1、存储产品线持续升级迭代

在 NAND Flash 领域，公司 SLC NAND Flash 产品制程覆盖 3xnm-2xnm-1xnm，产品容量覆盖 512Mb~16Gb，内置 ECC 模块，具备 10 万次擦写寿命及高耐久、宽温稳定运行特性。报告期内，公司继续加强在 SLC NAND Flash 行业的技术领先优势，通过电路设计优化与工艺调整，推动存储产品升级迭代。目前，公司 1xnm

及 2xnm 制程产品的擦写寿命及数据保持特性均已满足主流应用要求并持续量产。公司正基于上述先进制程持续扩充产品品类，充分释放先进制程带来的成本与性能竞争优势。

在 NOR Flash 领域，公司持续推进 48nm、55nm 制程下 64Mb~2Gb 中高容量的 NOR Flash 产品的研发，产品广泛覆盖可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子、端侧 AI 等应用领域。公司精准定位不同容量的客户需求，持续优化性能、功耗与性价比的合理匹配。随着产品迭代升级，公司不断丰富 NOR Flash 产品矩阵，进一步强化了在高可靠性场景下的解决方案能力。此外，公司在实现 1.8V、3.3V 全品类覆盖的基础上，进一步研发 1.2V 更低功耗 NOR Flash，可有效降低系统整体功耗，更好契合便携设备、可穿戴设备及物联网模组等应用场景对低功耗、长续航的需求。

在 DRAM 领域，公司已实现 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、LPDDR4X、PSRAM 等产品的量产，并持续进行 LPDDR4X、DDR4 等新产品研发布局。公司产品凭借小尺寸封装、低电压设计及宽温适应性，覆盖消费电子、工业及汽车电子等多元化应用场景，在移动设备轻薄化、工业场景高可靠性及 AIoT 数据处理需求中展现出技术优势。公司将继续拓宽 DRAM 产品线，推动产品矩阵多元化发展。

在 MCP 领域，公司目前已可提供 4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 等多种组合的 MCP 产品，主要应用于 5G 通讯模块、车载模块等领域。公司在研产品进一步拓展多容量配置，依托自主研发的 SLC NAND Flash 与 DRAM 组合，打造具备成本优势与稳定性能的 MCP 解决方案，持续丰富产品线，全面满足客户的多样化需求。

2、车规级存储产品矩阵加速构建

公司持续提升车规级存储产品可靠性水平，稳步推进研发及产业化进程。在车规级存储领域，公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 及 MCP 三大品类的车规产品阵容持续扩充，更多型号顺利通过 AEC-Q100 验证。报告期内，公司持续在多款车型中进行车规产品的量产交付，并进一步推进整车厂的白名单导入，加速推进更多海内外 Tier 1 厂商的导入与销售落地。相关产品已成功应用于通信及远程控制系统、激光雷达、机器视觉、电池 BMS 系统及智慧座舱等汽车电子核心系统。

（二）深化“存、算、联”一体化战略，优化业务布局

报告期内，公司持续推进“存、算、联”一体化战略布局，通过技术创新、生态

协同与产业链延伸，逐步构建起以存储芯片为核心，向计算、通信领域延伸的多元化技术生态体系，旨在建立一体化的生态发展体系，为未来增长注入新动能。

1、“联接”芯片：Wi-Fi 7 研发取得阶段性成果

公司持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计，精准切入技术壁垒较高的路由、高端黑电透传及车载类 Wi-Fi 等细分赛道。公司首款无线传输芯片定位于高带宽、低延迟应用场景。报告期内，公司在前期完成原型机样片测试的基础上，持续深化首款无线传输芯片的架构优化与系统级方案打磨。目前主要核心模块已完成实验室验证，测试结果符合预期，核心性能指标已满足 Wi-Fi 7 标准要求。公司正全力推进系统级验证与流片进程，并同步筹备后续的客户送样与导入工作。通过差异化技术创新，公司致力于为客户提供本土化的智能无线通信与感知芯片及系统级解决方案，积极培育业绩增长新动能。

2、“计算”芯片：GPU 战略布局深化

在计算芯片领域，公司通过自有资金战略投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”），布局高性能 GPU 赛道。上海砺算专注于多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，坚持核心 IP 自研，在 GPU 架构设计等关键技术环节拥有完整的自主知识产权。报告期内，上海砺算重点围绕产品生态完善、量产工艺优化及市场化导入开展工作。在生态认证与产品优化方面，报告期内成功获得微软 WHQL 认证，标志着产品在 Windows 操作系统环境下具备良好的兼容性与稳定性，为进一步拓展主流商业化市场奠定了基础。同时，上海砺算持续推进量产制造工艺的优化，提升产品综合竞争力；在软硬件生态建设方面，持续推进跨平台适配，目前已成功兼容多款主流国产操作系统及处理器平台，并积极与操作系统、处理器、独立软件开发商及整机制造商等产业链上下游厂商开展协同合作，共同推进软硬件适配与行业应用解决方案的落地，为商业化应用奠定生态基础。在市场导入与商业化方面，针对 7G100 产品，上海砺算采取专业级与消费级双线并行的市场策略。在专业级显卡领域，由于产品主要面向 AI PC、云渲染、数字孪生等前沿应用领域客户，从技术验证到采购落地周期较长，目前整体销售尚处于起步阶段，主要工作聚焦于重点应用场景的客户导入与系统级验证；在消费级显卡领域，产品已于报告期内成功上线主流电商平台并开启市场化销售，完成了多轮驱动版本的迭代升级，持续扩展应用兼容性并优化实际运行性能。在下一代产品研发方面，为紧跟图形渲染与 AI 技术演进趋势，上海砺算下一代 GPU 芯片的研发工作正稳步推进。

进，报告期内各项核心模块的架构设计与验证工作进展顺利，为后续产品性能的提升与迭代落地奠定了坚实基础。

（三）保持高水平研发投入，坚持核心技术自主可控

公司高度重视知识产权的自主性与完整性，在不断开发新技术、新产品的同时，通过多种途径对相关的知识产权进行保护。报告期内，申请中国发明专利 21 项，获得发明专利授权 5 项；申请实用新型专利 1 项；申请软件著作权 5 项，获得软件著作权 3 项；申请集成电路布图设计权 7 项，获得集成电路布图设计权 2 项；申请注册商标 13 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 123 项、软件著作权 18 项、集成电路布图设计权 84 项、注册商标 18 项。公司专利涉及 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片的设计核心环节，技术护城河不断加深。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，建立了包括股东会、董事会和管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权责明确、运作规范的公司治理体系。

报告期内，公司根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《东芯半导体股份有限公司章程》《对外投资管理办法》《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多部公司治理制度进行了制定、修订。上述制度的制定与修订，进一步夯实了公司规范运作的制度根基，有效提升了治理体系的科学性与有效性，强化了风险防范与应对能力。

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数人员”的培训工作，组织相关人员积极参加各类合规培训。报告期内，公司积极组织董事、高级管理人员及相关工作人员参加上海证券交易所、上海上市公司协会等举办的各类培训，加强证券市场相关法律法规的学习，不断强化合规意识，提升公司董事、高级管理人员履职能力，推动公司持续规范运作。

三、加强投资者沟通，提升信息披露质量

公司坚持以投资者需求为导向，持续完善多渠道、多层次的投资者沟通体系。

在信息披露文件中突出价值信息的针对性与重要性，在定期报告中强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，为投资者的价值判断与决策提供充分依据；同时依法依规、适时开展自愿性信息披露，积极传递公司内在价值与投资潜力。

公司充分尊重并维护股东合法权益，认真听取投资者对公司战略发展、经营管理等方面的意见建议。报告期内，公司常态化、高效地组织定期报告业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监等核心管理层出席，与投资者积极互动交流；组织并参加路演、反路演、策略会等投资者调研活动约 87 场；通过股东会、上证 e 互动、官网投资者关系专栏、投资者热线及邮箱等多元化渠道开展沟通交流，切实保障投资者的知情权与参与权。

此外，为进一步强化市值管理的透明度与投资者沟通，公司于 2026 年 5 月 12 日在 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会上，专门就公司市值管理制度的执行情况进行了专项说明。通过主动、详实地向市场汇报市值管理举措的落地情况，公司有效回应了市场关切，切实保障了广大投资者的知情权与监督权。

公司不断探索创新信息披露形式，积极采用图文、视频、语音等多元化载体，提升信息披露的可读性与实用性。公司通过微信公众号“东芯半导体”推出“一图读懂”系列图文解读，报告期内累计发布推文 20 余篇，粉丝总数超 19,000 人。报告期内，公司积极参与上海证券交易所、上证路演中心举办的“科创 3 分钟·高管开放麦”活动，由公司董事长以短视频形式发表“穿越周期，构建‘存、算、联’的硬科技生态”讲话，帮助投资者更直观、透彻地理解公司中长期发展战略与业务逻辑。

此外，公司积极践行可持续发展理念，重视 ESG 对企业发展的作用，将其融入商业模式与管理体系。公司披露了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面展现了公司在环境保护、社会责任及公司治理领域的实践与绩效（详见公司 2026 年 4 月 23 日披露的相关报告）。

四、完善投资者回报机制，提升投资者信心

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，在注重生产经营的同时，重视广大投资者的回报，通过多种方式维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。

鉴于芯片行业需持续投入大额研发开支，且公司近年来围绕“存、算、联”一体化战略的前瞻性技术布局尚处于投入期，较高水平的研发投入及对外投资使得

公司短期利润承压，截至 2025 年末母公司未分配利润为负，暂不具备现金分红的基础条件。为建立健全长效的股东回报机制，畅通分红渠道，公司股东会于 2026 年 5 月审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并于 2026 年 6 月顺利实施完成。本次以公积金弥补亏损后，公司将消除未分配利润为负的状况，从而具备分红基础条件，为与股东共享发展成果创造必要前提。

公司始终秉持以投资者为本的理念，致力于通过切实行动回馈广大投资者的信任与陪伴。公司综合考量了战略规划、研发投入及日常营运资金需求，在财务状况稳健、现金流充裕且能充分保障公司持续发展的前提下，审慎制定了 2026 年中期利润分配及资本公积转增股本方案，积极与全体股东共享企业成长红利。2026 年 8 月 20 日，公司董事会审议通过了《关于 2026 年中期利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以公司总股本扣除公司股份回购专户股数为基础，以此计算拟派发现金红利 263,922,297.60 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.03%；拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计拟转增股本约 215,536,543 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。本方案将在股东会审议通过后实施。

五、重视人才培养，健全长效激励机制

公司始终坚持“以人为本”的发展理念，秉持“人才优先，服务发展，使用为本”的原则，视人才为企业发展的核心驱动力。公司注重员工能力培养与职业发展，制定并实施系列培训管理规范与内训师管理制度，构建起涵盖人才培养开发、评价选拔、流动配置、激励保障的特色培训管理体系，形成覆盖全员、贯通全周期的入职培训与在岗培训体系，推动各类培训项目有机衔接、协同落地。

公司常态化开展培训需求调研，广泛征集并梳理员工培训诉求，科学制定年度培训计划。在分层级培养方面，公司全力打造多元化、高质量的人才队伍：针对新员工，开展入职引导及项目实战演练，帮助新员工快速融入公司文化与工作节奏；对于技术人员，以市场需求与行业技术发展为导向，为核心技术储备人才制定专项培养计划，通过长期技术培训、专题讲座及团队技术专家“以老带新”等方式，提升员工专业素养、增强归属感与责任意识；针对管理梯队，打造领导力发展项目，形成分类分层、精准施训的培养格局。

同时，公司充分发挥内部讲师在知识传承中的核心作用，严格选拔兼具专业素

养与表达能力的员工作为内训师，通过分级认定与授课激励机制，持续激发讲师队伍活力。针对关键岗位及特殊工种，公司定期开展专业技能、质量意识、职业安全等专项培训，并结合训后考核与效果评估，持续优化课程内容与授课质量，为员工能力提升与长远发展提供有效支撑。

在激励机制方面，公司不断完善激励约束机制，优化薪酬体系与绩效考核制度，建立健全公司长效激励机制，充分调动公司各管理层和核心业务（技术）骨干的积极性，增强公司凝聚力。为了进一步吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，公司已连续多年推行股权激励计划。报告期内，公司顺利实施了 2026 年度股权激励方案，并完成了 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关归属期的股份归属工作。

公司为股权激励计划设置了科学严谨的考核体系，选取了营业收入增长率作为公司层面的业绩考核要求，并对所有激励对象设置了个人层面的绩效考核要求，根据激励对象的年度考核结果确定其是否符合归属条件或行权条件。以上考核体系有效实现了股权激励的约束作用，提升了激励对象的积极性，有助于提升公司活力及发展动力，促进公司健康长远可持续发展，增强投资者回报。

六、其他事宜

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。下半年，公司将继续积极推动并落实 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提升盈利能力、提高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日